

Title (en)  
Metallisation method with protective layer

Title (de)  
Metallisierungsverfahren mit Schutzschicht

Title (fr)  
Procédé de métallisation avec couche de protection

Publication  
**EP 2835446 A1 20150211 (DE)**

Application  
**EP 13179697 A 20130808**

Priority  
EP 13179697 A 20130808

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Metallisieren einer Bauteiloberfläche, wobei nach einer Sulfonierung zur Vorbereitung eine Schutzschicht auf einem Teil der Oberfläche abgeschieden und danach auf dem nicht durch die Schutzschicht abgedeckten Teil eine Bekeimung und nachfolgende Metallisierung durchgeführt wird.

IPC 8 full level  
**C23C 18/16** (2006.01); **C23C 18/20** (2006.01); **C23C 18/30** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**C23C 18/1605** (2013.01); **C23C 18/2006** (2013.01); **C23C 18/208** (2013.01); **C23C 18/2086** (2013.01); **C23C 18/30** (2013.01)

Citation (search report)

- [XYI] US 4666739 A 19870519 - ROUBAL JIRI [DE]
- [X] CA 1007523 A 19770329 - KOLLMORGEN PHOTOCIRCUITS
- [XY] US 2400720 A 19460521 - PETER STAUDINGER HANNS, et al
- [A] US 4594311 A 19860610 - FRISCH DAVID C [US], et al
- [A] US 2008175986 A1 20080724 - CROUSE KENNETH [US], et al
- [A] US 5296020 A 19940322 - REICHERT GUENTHER [DE], et al
- [A] US 4039714 A 19770802 - ROUBAL JIRI, et al

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2835446 A1 20150211**

DOCDB simple family (application)  
**EP 13179697 A 20130808**